

SiCウェーハ仕上研削用

平面研削
バックグランド

ビトリファイドボンドホイール

高硬度のSiCウェーハにおいて加工精度の向上と長寿命の両立を可能にした
ビトリファイドボンドホイールです

特長

■ 低負荷研削

新開発した**特殊ボンド採用**により、
ウェーハへの食いつきに必要**な砥粒間隔を確保し**、
超微粒領域においても**低負荷で安定した切れ味**が持続します

■ 長寿命

高保持力ボンドにより、砥粒の過度な脱落を抑えて、
砥粒を効率的に作用させること**ができるため、長寿命化が可能**となります

効果

■ 加工精度向上と加工コスト低減

低負荷で安定した切れ味の持続により、加工精度が向上
また、長寿命工具であることから、加工コスト低減に貢献します



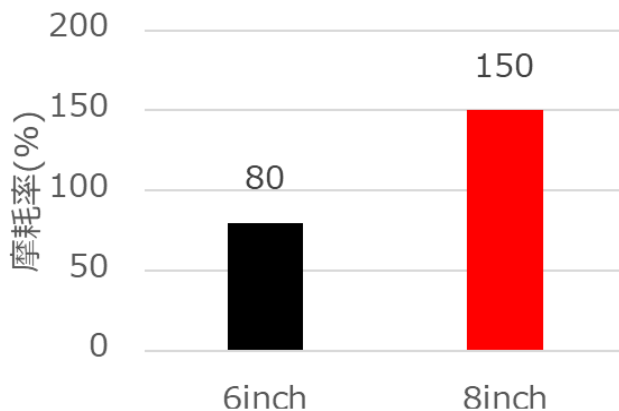
評価事例

【加工条件】

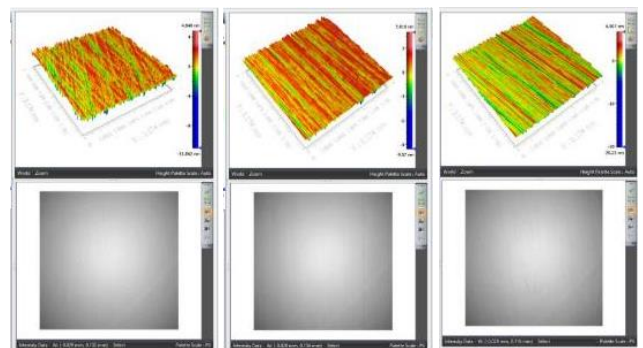
ホイール粒度	#8000		
ワーク	6inch SiCウェーハ, 8inch SiCウェーハ		
送り速度	0.3 μ m/sec.		
取り代	10 μ m		
ホイール回転数	2500 rpm	ウェーハ回転数	300 rpm

■ 摩耗率

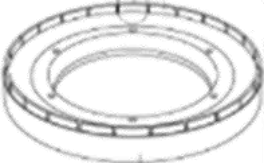
■ 表面粗さ(6inchウェーハ)



Sa: < 1nm (Zygo)



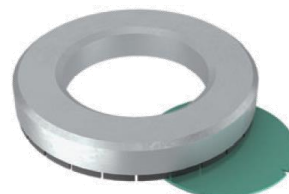
製造範囲

砥粒	SD		
粒度	8000番		
結合度	I ~ J		
寸法	ホイール外径 D(mm)	砥材層幅 W(mm)	砥材層厚み T(mm)
	200~300	3~4	5~7
形状	カップホイール 		

適用用途

表記外の寸法、スペックについてはご相談ください

- 半導体用高硬度脆性材料
ワーク材質 : SiC
加工方式 : 平面研削、バックグラインド



ノリタケ株式会社

工業機材事業本部

[本社]

〒451-8501 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

TEL:052-561-9817 FAX:052-561-9759

E-mail: grinding@noritake.com

<https://www.noritake.co.jp/>

* 本カタログに掲載の内容は予告無く変更する場合がありますので御了承ください。